

ICSMM 2021

2021年第五届传感器、材料和制造国际会议

中国澳门大学
2021年11月19-21日

重要日期

投稿截止时间	2021年8月15日
发通知时间	2021年9月5日
注册截止时间	2021年9月20日

投稿方式

1. 系统投稿: <http://confsys.iconf.org/submission/icsmm2021>

2. 直接发到会议邮箱: icsmm@cbees.net

模板:

摘要投稿: [Click](#)

全文投稿: [Click](#)

更多投稿指南, 请查看网址: <http://www.icsmm.org/sub.html>

出版物



Materials Science Forum (ISSN print 0255-5476 / ISSN web 1662-9752), 能被Ei Compendex, Scopus等检索

出版历史

ICSMM 2020 – Key Engineering Materials: Volume 891. [978-3-0357-1789-1]

ICSMM 2019 – Solid State Phenomena: Volume 305. [ISBN: 978-3-0357-1657-3]

Ei Compendex & Scopus已成功检索

ICSMM 2018 – Material Science Forum: Volume 962. [ISBN: 978-3-0357-1416-6]

Ei Compendex & Scopus已成功检索

ICSMM 2017 – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.311

Ei Compendex & Scopus已成功检索

大会嘉宾



邢锋教授
广东省教育厅副厅长, 深圳大学



Kwang Leong Choy 教授
伦敦大学学院



潘晖教授, 澳门大学



陈生明教授, 台北科技大学



Han-Yong Jeon教授
仁荷大学

征稿主题

新材料和先进材料

1. 有色金属材料
2. 钢铁
3. 复合材料

电子材料

1. 电子材料半导体材料
2. 展示材料
3. 电池材料

传感器技术

1. 传感器用半导体材料
2. 传感器用高分子材料
3. 机械传感器

更多会议主题, 请查看网址: <http://www.icsmm.org/cfp.html>

联系我们

张女士

邮箱: icsmm@cbees.net

电话: +86-28-87577778

扫描以下二维码添加我们的微信



微信号:
[cmsconference](https://www.icsmm.org/cfp.html)



微信公众号:
CBEEES

共同主办方:



支持单位:

